

股票代碼：3580

友威科技 營運簡報

Date：113/03/06

投資人關係聯絡方式：

E-mail：theresachen@uvat.com

UVAT
Vacuum Ecosystems

會議流程

01

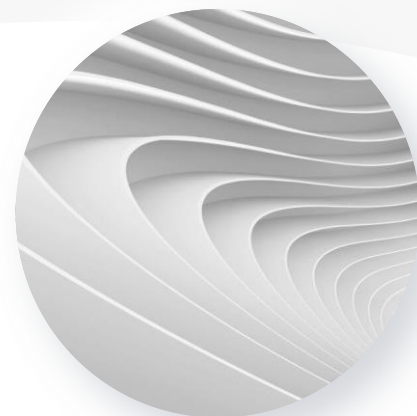
公司沿革

02

技術分享與產品

03

經營實績

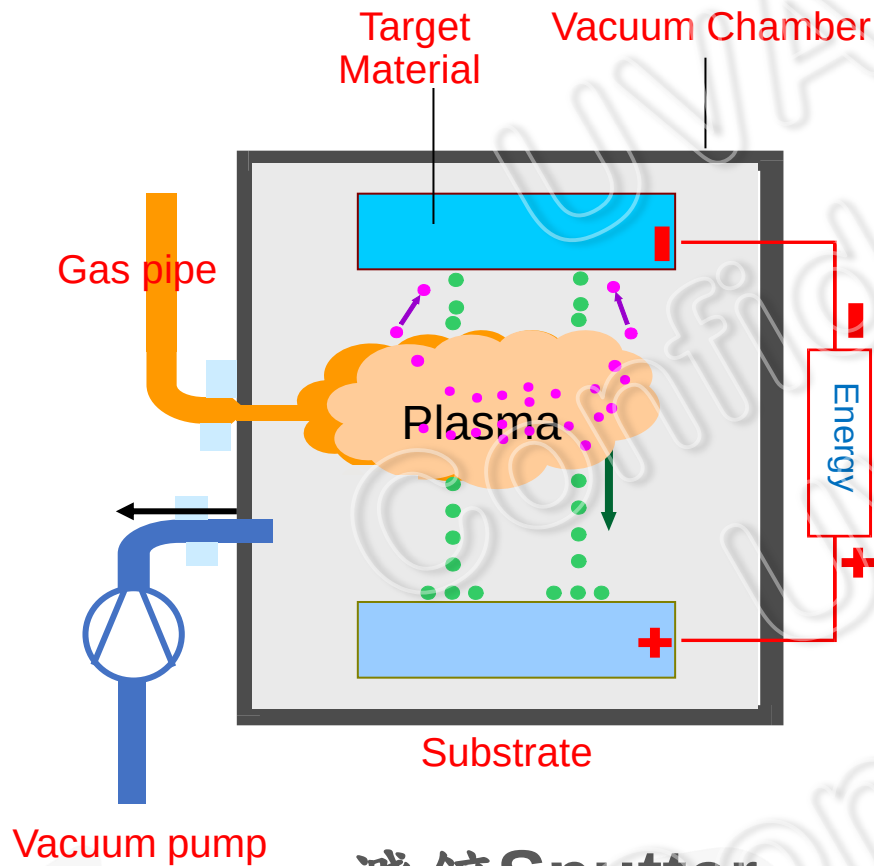


The background features a series of concentric circles and curved lines in shades of light blue and white, creating a sense of depth and movement.

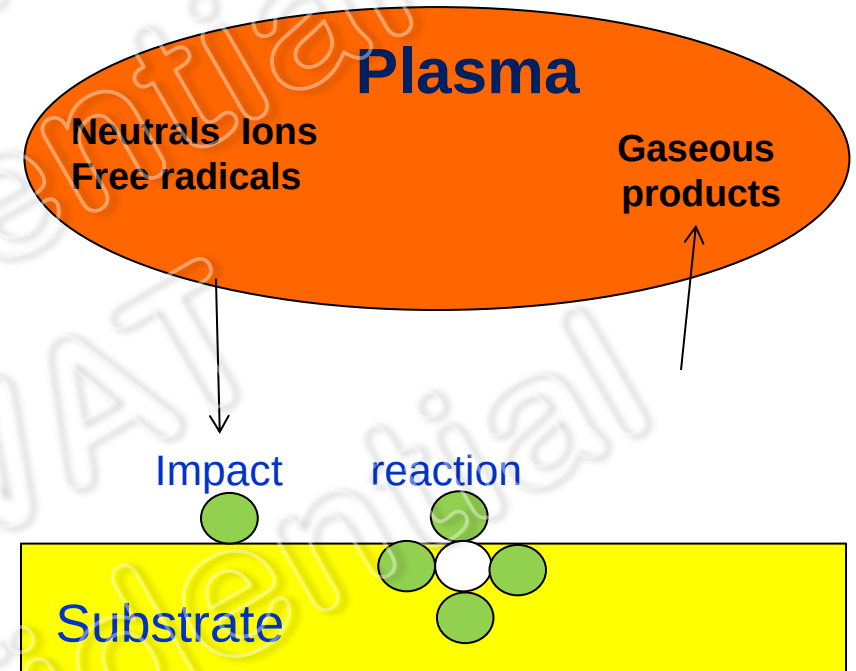
01

公司沿革

乾式(Dry)製程的解決方案



濺鍍Sputter



電漿蝕刻Plasma Etch

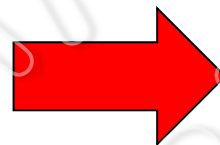
友威的核心

乾式Dry
真空製程

綠色製程
環保製程

濺鍍
Sputtering

蝕刻
Etching



薄型化
薄膜化

關於友威

成立時間	2002/11/04
董事長暨總經理	李原吉
資本額	新台幣3億9,470萬
員工	台灣：120人 中國：約300人
服務項目	真空濺鍍設備 蝕刻設備 半導體設備及相關耗材 鍍膜代工 光學鍍膜 薄膜元件



- ❖ 2007年股票公開發行
- ❖ 2008年Forbes亞太200大最佳中小企業
- ❖ 2010年7月9日股票上櫃(友威科3580)

里程碑

2002-2010

2010-2015

2015-2020

2020-2023



台灣精品獎

UVAT

產業類別：生產力&能源精品

產品型號：鈦銅種子層濺鍍機

連續式真空濺鍍機

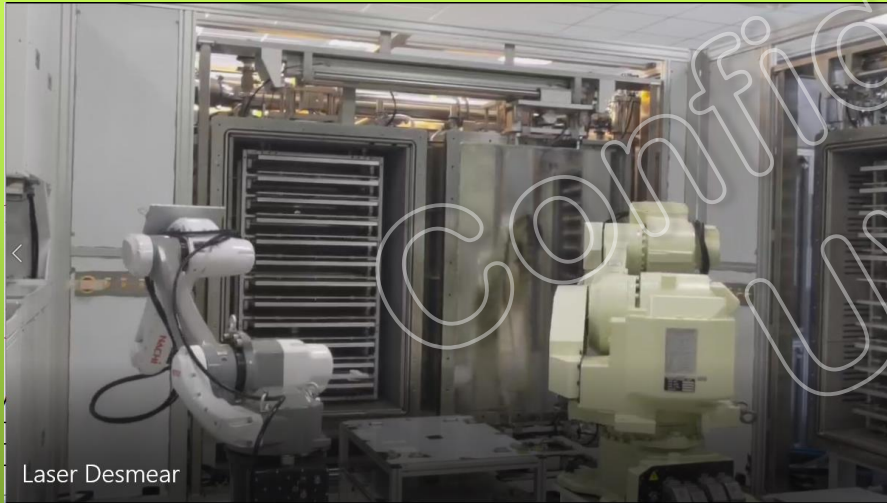


台灣精品 2021
TAIWAN EXCELLENCE



蝕刻 Dry Etch

- Panel level plasma treatment



- High aspect ratio plasma descum



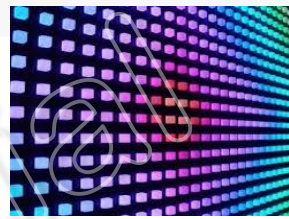
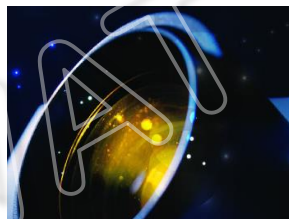
- Fine pitch metal etch



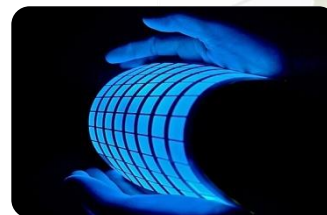
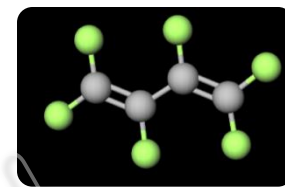
主要市場



汽車



石英產業



晶片內埋

半導體封裝

IC 載板
電路板



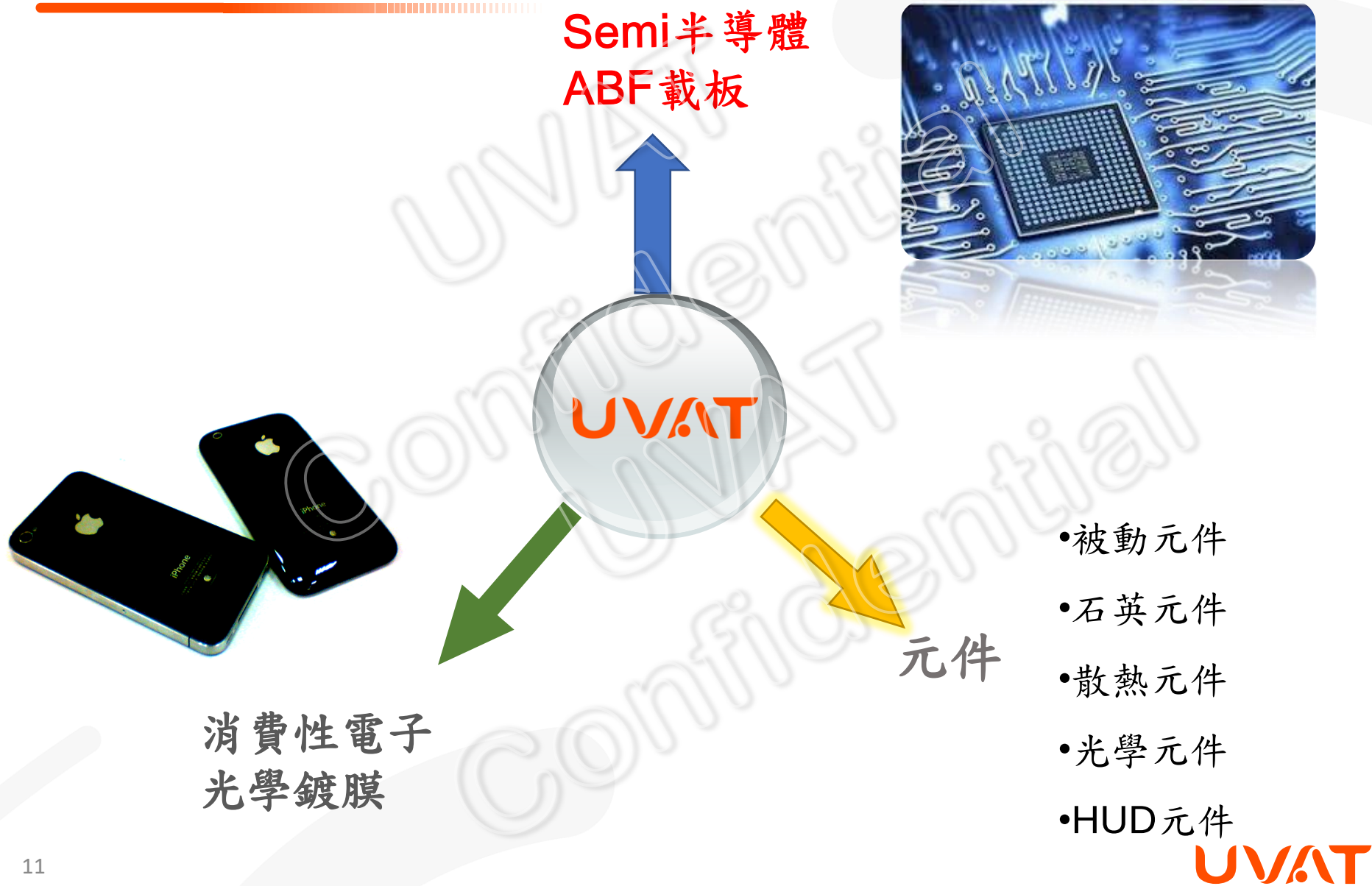
被動元件

光學
產業

消費性
電子



未來主要市場

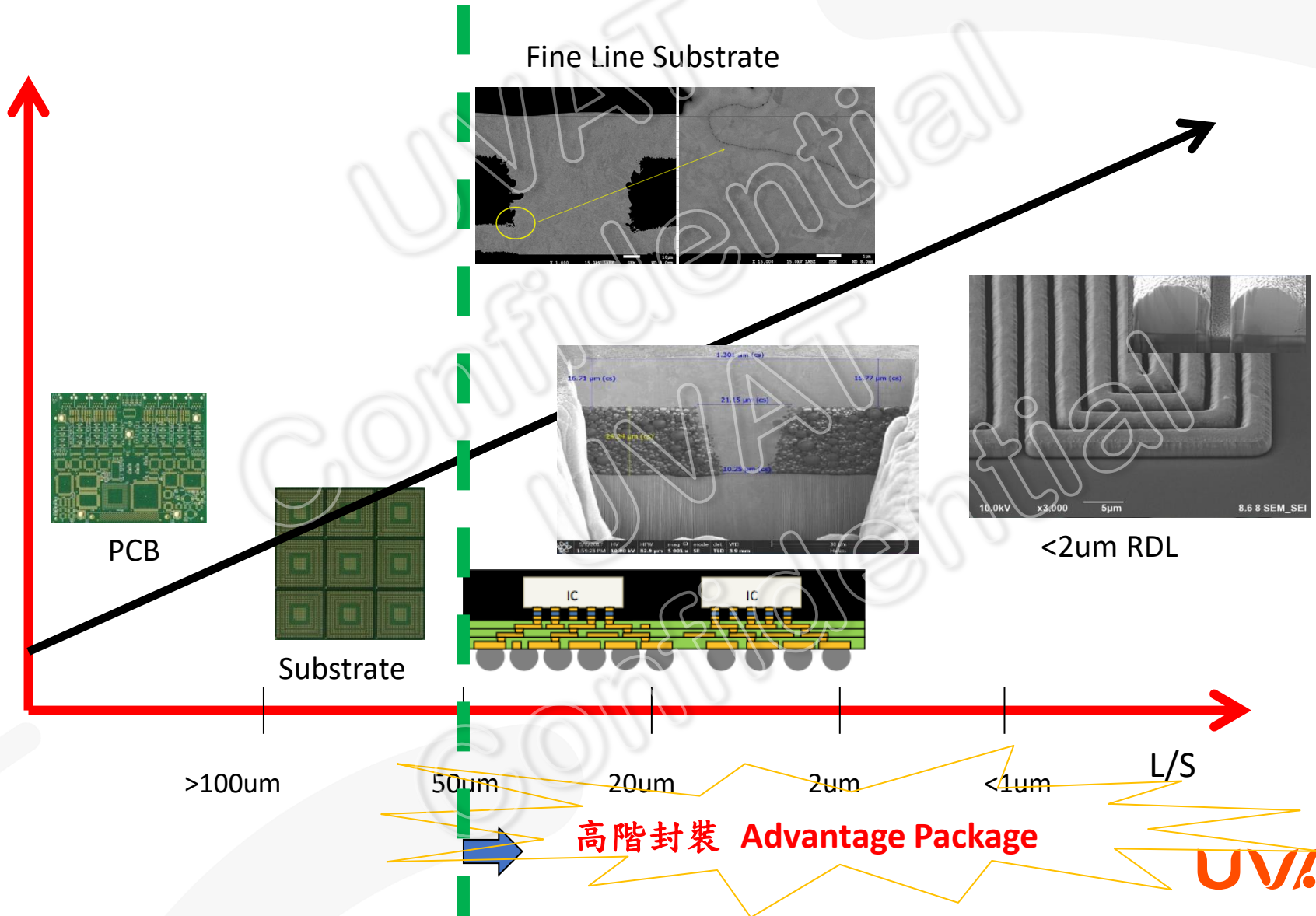




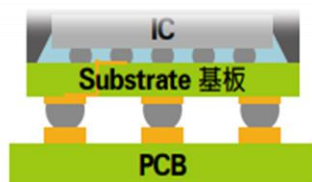
02

技術分享與產品

Line/Space Evolution in Semiconductor

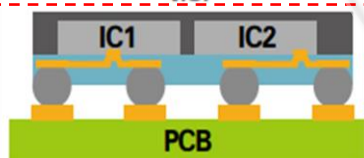


封裝應用的發展_FOPLP



覆晶封裝

V.S.



扇出型封裝

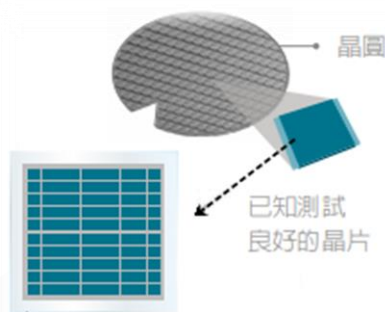
中高階載板供應不足下，驅使無載板、可
一次性大面積封裝且有效降低製造成本的
面板級封裝 **FOPLP** 應用備受矚目。

優勢：

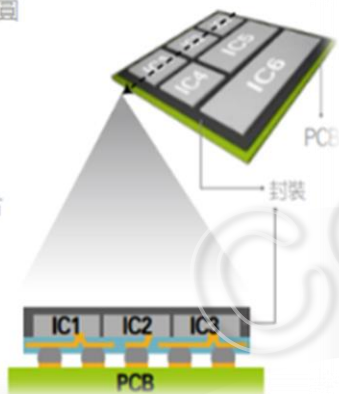
- 挑出良好IC 進行封裝，提升良率
- 多晶片異質晶片整合
- 縮小封裝體積
- 大面積封裝降低成本

良率提升

多晶片整合



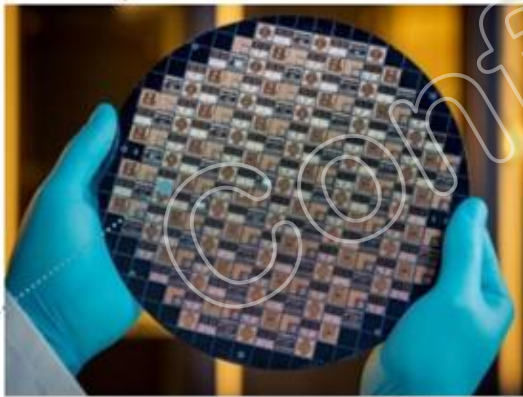
透明玻璃、電路板
或其他半導體材料



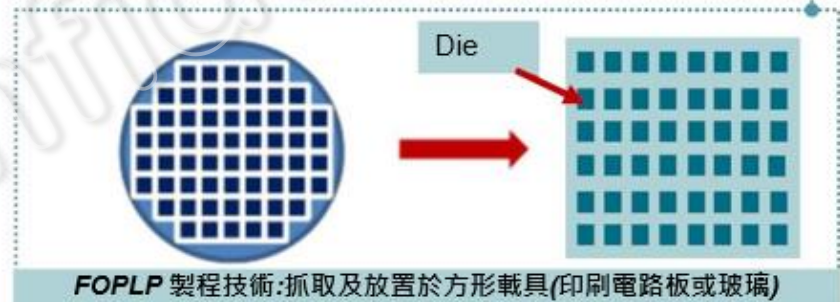
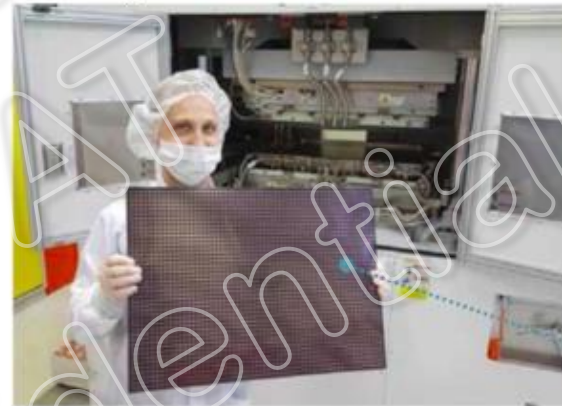
FOPLP (Panel Lever Packing) 的優勢

- 較低成本: 印刷電路板/面板基礎技術應用於FOPLP，可以減少在晶圓上成本。
- 方法:
 1. 使用印刷電路板/面板製程技術製作RDL（線路重佈層），線寬/線距 $>10\mu\text{m}$ 。
 2. 使用SMT設備進行模具和上下料取放。
 3. 使用大面積面板進行製造，可以一次性封裝更多晶片。

FOWLP ↓



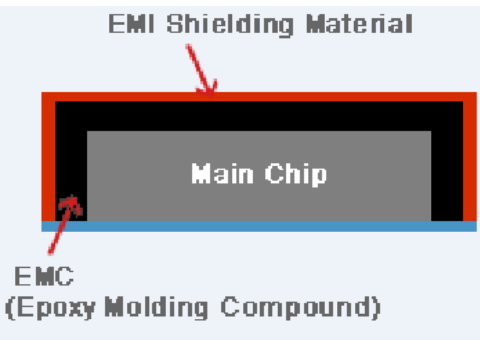
FOPLP ↓



IC封裝產業應用

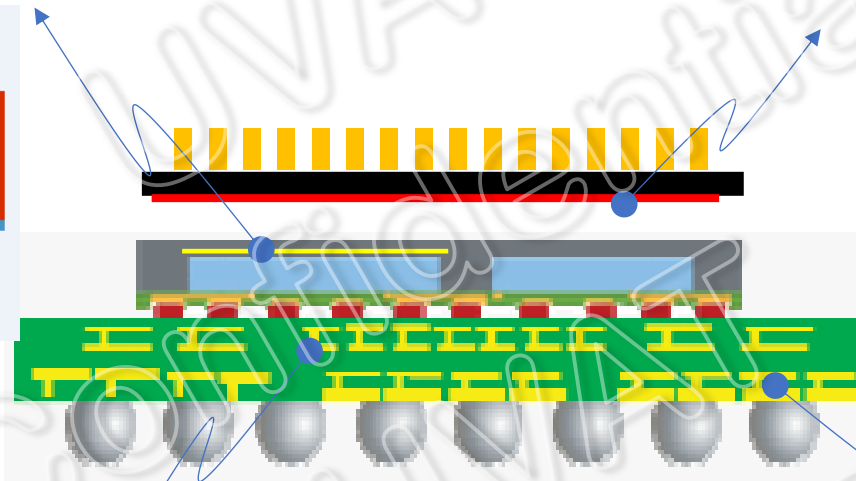
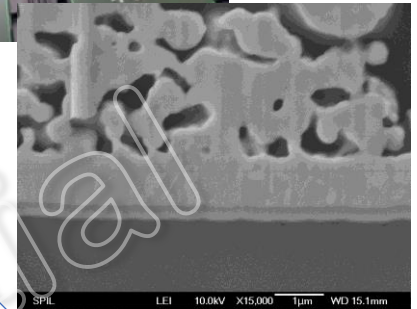
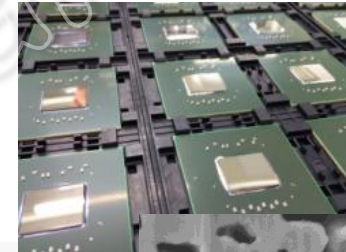
SIP EMI

SUS/Cu/SUS



Thermal Dissipation

Ti/NiV/Ag, Ti/NiV/Au



Plasma Etcher

- Ti/Cu Seed Layer Dry Etch
- Plasma Descum
- Plasma Pre-treatment



Seeding Sputter

Ti/Cu



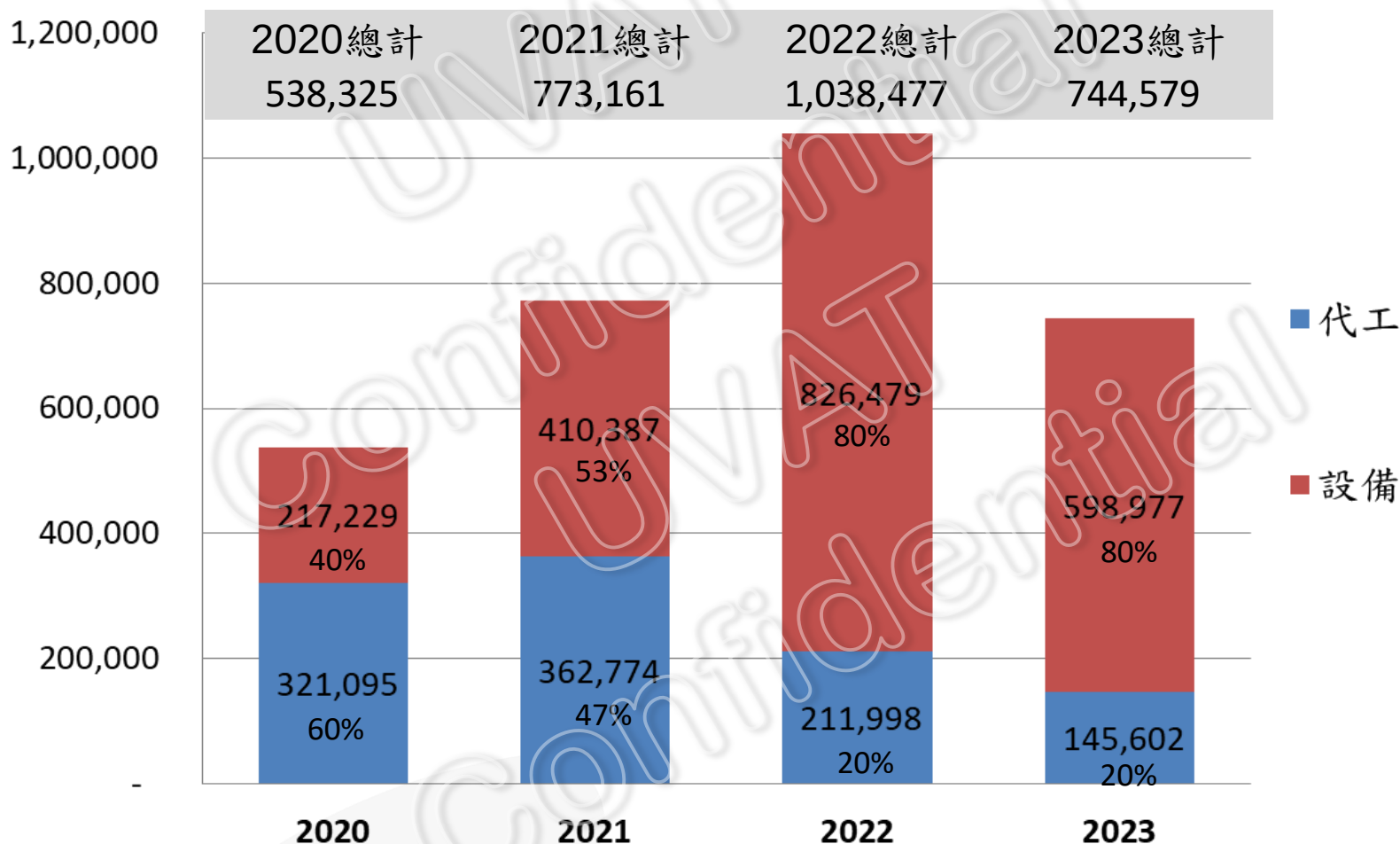


03

經營實績

2020~2023各年度收入分類

單位：NTD仟元



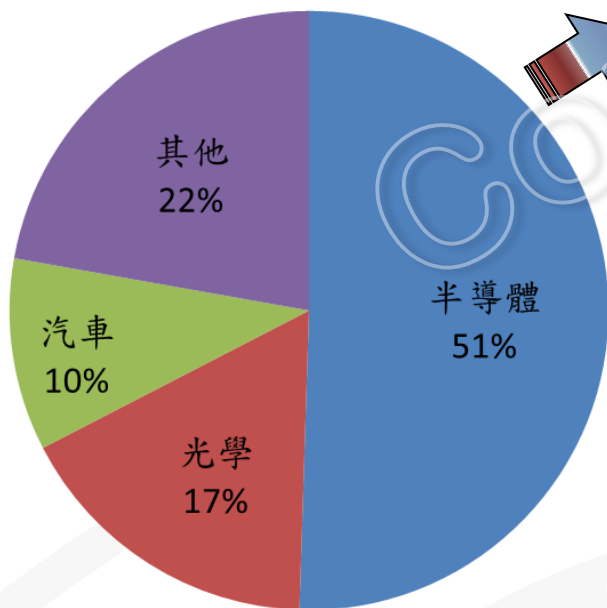
2020~2023簡明損益表

單位：NTD仟元

年度	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
營業收入	538,325	100%	773,161	100%	1,038,477	100%	744,579	100%
營業成本	360,743	67%	485,494	63%	561,008	54%	433,846	58%
營業毛利	177,582	33%	287,667	37%	477,469	46%	310,733	42%
營業費用	126,879	24%	151,613	20%	200,726	19%	187,679	25%
營業淨利	50,703	9%	136,054	18%	276,743	27%	123,054	17%
稅前淨利	76,553	14%	141,451	18%	328,355	32%	133,343	18%
稅後淨利	70,772	13%	116,120	15%	247,299	24%	102,216	14%
EPS	1.84		3.02		6.37		2.63	

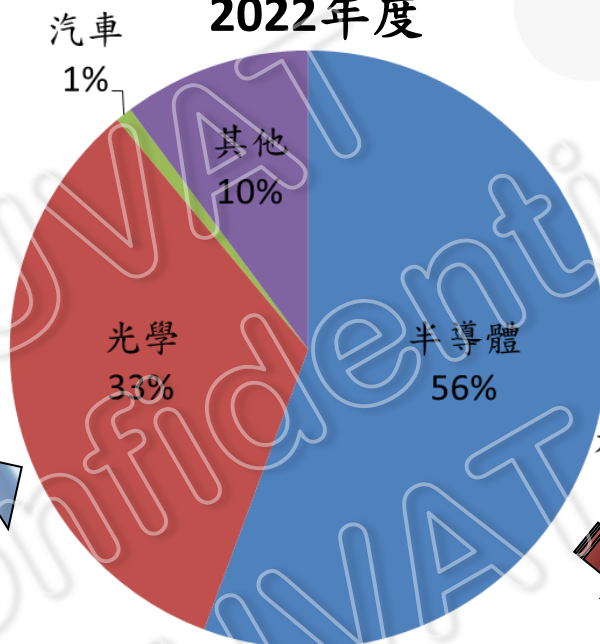
2021~2023設備收入產業別

2021年度



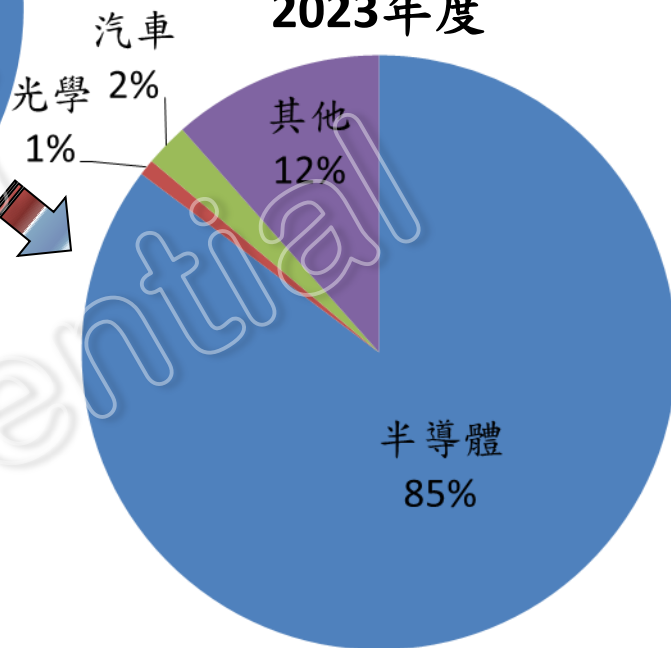
半導體金額：
207,288仟元

2022年度



半導體金額：
458,444仟元

2023年度



半導體金額：
510,701仟元

免責聲明

- ◆ 本簡報及同時發布之相關訊息所提及之預測性資訊，包括營運展望、財務狀況及業務預測等內容，係本公司基於內部資料及外部整體經濟發展現況所得之資訊。
- ◆ 本公司未來實際產生之營運結果、財務狀況與業務成果，可能與預測市場及資訊需求、價格異動、競爭之風險等，包括但不限於匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動、國際經濟狀況、匯率波動。
- ◆ 本簡報中所提供之資訊，係反映本公司截至目前為止對未來之看法，並未明示或暗示其具有正確性、完整性或可靠性。對簡報內容，未來若有變更或調整，本公司或不負責任或修正。
- ◆ 未經本公司允許情況下，不可複製、修改、重新編譯、刪減或傳送本簡報任何內容，或將任何該等內容作為商業用途。



Vacuum Ecosystems

Thank you

友威科技股份有限公司
UVAT Technology Co., Ltd.

